

QJ

中国航天工业总公司航天工业行业标准

QJ 3044—98

半导体集成电路数/模转换器和 模/数转换器测试方法

1998—02—06 发布

1998—08—01 实施

中国航天工业总公司 发布

目 次

1 范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 定义	(1)
4 一般要求	(1)
5 详细要求	(3)
附录 A 10 位 DAC 误差测试示例(参考件)	(22)
附录 B 12 位 ADC 误差测试示例(参考件)	(24)

半导体集成电路 模/数转换器和数/模转换器测试方法

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了半导体集成电路数/模转换器(以下简称器件,缩写 DAC)和模/数转换器(以下简称器件,缩写 ADC)电参数的测试方法。

1.2 适用范围

本标准适用于研制生产单位和使用单位对半导体集成电路中低速 DAC 和 ADC 电参数的测试。

2 引用文件

- GB 3431.1—82 半导体集成电路文字符号 电参数文字符号
- GB 3431.2—86 半导体集成电路文字符号 引出端功能符号
- GB 3439—82 半导体集成电路 TTL 电路测试方法的基本原理
- GB 3441—82 半导体集成电路 ECL 电路测试方法的基本原理
- GB 3834—83 半导体集成电路 CMOS 电路测试的基本原理
- GB 9178—88 集成电路术语
- QJ 2614—94 高速 A/D 转换器动态特性测试方法

3 定义

本规范采用的术语和符号按 GB 9178、GB 3431.1 和 GB 3431.2 的规定。

4 一般要求

4.1 对测试的要求

4.1.1 若无特殊说明,测试期间,环境温度或参考点的温度偏离规定值的范围应符合被测器件详细规范的规定。

4.1.2 测试期间,避免外界干扰对测试精度的影响。测试设备引起的测试误差应符合被测器件详细规范的规定。

4.1.3 测试期间,被测器件应按器件详细规范的规定连接辅助电路。